

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】令和6年8月19日(2024.8.19)

【公開番号】特開2023-106423(P2023-106423A)

【公開日】令和5年8月1日(2023.8.1)

【年通号数】公開公報(特許)2023-143

【出願番号】特願2023-74142(P2023-74142)

【国際特許分類】

B 2 2 F 1/00(2022.01)

B 2 2 F 1/054(2022.01)

B 2 2 F 1/17(2022.01)

B 2 2 F 9/24(2006.01)

B 2 2 F 9/08(2006.01)

B 2 2 F 1/05(2022.01)

B 8 2 Y 30/00(2011.01)

B 8 2 Y 40/00(2011.01)

10

【F I】

B 2 2 F 1/00 K

B 2 2 F 1/054

B 2 2 F 1/17

B 2 2 F 9/24 E

B 2 2 F 9/08 A

B 2 2 F 9/24 F

B 2 2 F 1/05

B 8 2 Y 30/00

B 8 2 Y 40/00

20

【手続補正書】

【提出日】令和6年8月8日(2024.8.8)

30

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

銀粉と、当該銀粉よりも小さい一次粒子からなる銀層とを有する銀粒子であって、カルボン酸、アルキルアミン、カルボン酸アミン塩、及びアミドから選ばれる少なくとも1種である有機保護化合物を含有する銀粒子。

40

【請求項2】

前記銀粒子が、平均粒子径が1 μm以上2.45 μm以下である銀粉の表面にさらに平均粒子径が20 ~ 50 nmの一次粒子が凝集してなる銀層を有する請求項1に記載の銀粒子

【請求項3】

タップ密度が4.0 ~ 7.0 g/cm³であり、かつBET法により求めた比表面積が0.5 ~ 1.5 m²/gである請求項1又は2に記載の銀粒子。

【請求項4】

請求項1 ~ 3のいずれかに記載の銀粒子を含むペースト組成物。

【請求項5】

50

請求項 4 に記載のペースト組成物を用いて接合されてなる半導体装置。

【請求項 6】

請求項 4 に記載のペースト組成物を用いて接合されてなる電気・電子部品。

10

20

30

40

50